

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-121507

(43)Date of publication of application : 30.04.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/60
// H01L 21/60

(21)Application number : 09-275964

(71)Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 08.10.1997

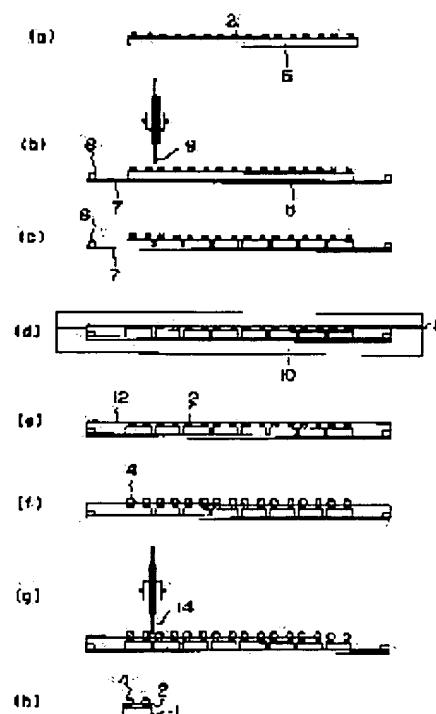
(72)Inventor : TAKAHASHI YOSHIKAZU

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate the formation of high reliable chip size packages by covering the surfaces and sides of a semiconductor element which has bump electrodes on the surface thereof.

SOLUTION: Bump electrodes 2 are formed on a wafer 5 formed of a circuit element. Next, the backside of the wafer 5 is pasted on a scribe ring 8 using a scribe sheet 7, so as to divide the wafer 5 into pieces. Next, the wafer 5 divided into pieces held by the scribe sheet 7 is contained in a mold metallic die 10 to be pressed for making surface levels of the gold bumps 2 uniform. Next, when a resin 12 is poured from a gate 11, the resin 12 is formed in a state with the surface of the bump electrodes 2 exposed. Later, solder balls 4 are mounted on the surface of the bump electrodes 2 so as to divide the wafer 5 with the resin 12 poured into gaps again into individual chips. Through these procedures, the chip size packages with the side of an LSI chip 1 also covered with the resin 12 can be formed easily.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3526731

[Date of registration] 27.02.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-121507

(43) 公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	F I	
H 0 1 L 21/60	3 1 1	H 0 1 L 21/60	3 1 1 Q
// H 0 1 L 21/60		21/92	6 0 2 L
			6 0 4 A

審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平9-275964

(22) 出願日 平成9年(1997)10月8日

(71) 出願人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 高橋 義和

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

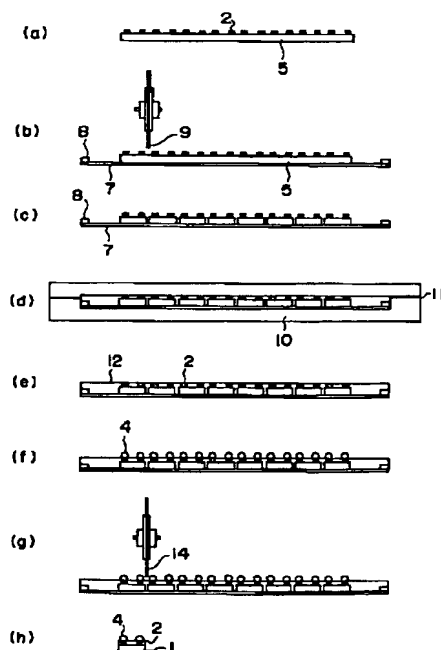
(74) 代理人 弁理士 大西 健治

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 半導体チップとほぼ同じ大きさのパッケージを効率よく製造する製造方法を提供する。

【解決手段】 ウエハ5をダイヤモンドブレード9を用いて個片に分割した後に、その隙間を含めたウエハ表面全体を樹脂12で封止し、ダイヤモンドブレード9よりも幅の狭いダイヤモンドブレード14を用いて再度個片に分割することにより、チップ1側面に樹脂を残した状態のチップサイズパッケージを得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に突起電極を有する半導体素子と、この半導体素子表面および側面を覆う封止樹脂と、前記封止樹脂から露出する前記突起電極と接続するボール電極と、

を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記突起電極表面が前記封止樹脂と略同一平面に形成されることを特徴とする請求項1項記載の半導体装置。

【請求項3】 請求項1項記載の半導体装置において、さらに半導体素子裏面が前記樹脂にて覆われていることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 表面に複数の素子領域を備えたウエハの前記複数の素子領域に突起電極を形成する工程と、前記ウエハ表面に前記複数の素子領域の境界を示す凹部を備えた封止樹脂を前記突起電極の表面を露出させて形成する工程と、

前記封止樹脂から露出した突起電極上にボール電極を形成する工程と、

前記凹部を基準として前記複数の素子領域を個々の素子に分割する工程と、

を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項5】 請求項4項記載の半導体装置の製造方法において、前記突起電極を形成した後に、前記突起電極表面の高さを揃えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項6】 請求項4項記載の半導体装置の製造方法において、前記凹部を備えた封止樹脂を形成する工程は、この凹部に対応する凸部を有する金型によりおこなうことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項7】 請求項6項記載の半導体装置の製造方法において、前記金型により樹脂封止する前に、この金型により前記突起電極表面の高さを揃えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項8】 請求項4項記載の半導体装置の製造方法において、前記突起電極はメッキにより形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項9】 請求項4項記載の半導体装置の製造方法において、前記凹部は前記複数の素子の分割される領域に沿って形成した溝であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】 表面に複数の素子領域を備えたウエハの前記複数の素子領域に突起電極を形成する工程と、前記突起電極の表面を含む前記ウエハ表面に前記ウエハ表面近傍まで到達する前記複数の素子領域の境界を示す凹部を備えた封止樹脂を形成する工程と、前記突起電極の表面が露出するまで前記封止樹脂を研磨する工程と、前記封止樹脂から露出した突起電極上にボール電極を形成する工程と、

前記凹部を基準として前記複数の素子領域を個々の素子に分割する工程と、

を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項11】 表面に複数の素子領域を備えたウエハの前記複数の素子領域に突起電極を形成する工程と、前記ウエハをスクライプシートに張り付けた後、前記複数の素子領域を個片に分割する工程と、前記分割された素子間の間隙を含む前記ウエハ表面に前記突起電極を露出させた状態で封止樹脂を形成する工程と、

前記封止樹脂から露出した突起電極上にボール電極を形成する工程と、

前記素子間の間隙に形成された封止樹脂の前記素子側面の樹脂を残した状態で前記素子を個片に分割する工程と、

を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項12】 前記素子を個片に分割する工程は比較的幅の広い第1のダイヤモンドブレードにより行い、前記素子側面の樹脂を残した状態で前記素子を個片に分割する工程は比較的幅の狭い第2のダイヤモンドブレードにより行うことを特徴とする請求項11項記載の半導体装置の製造方法。

【請求項13】 前記第1のダイヤモンドブレードの幅は前記第2のダイヤモンドブレードの幅の略2倍であることを特徴とする請求項12項記載の半導体装置の製造方法。

【請求項14】 表面に複数の素子領域を備えたウエハの前記複数の素子領域に突起電極を形成する工程と、前記ウエハをスクライプシートに張り付けた後、前記複数の素子領域を個片に分割する工程と、

前記スクライプシートを引き延ばし、前記分割された素子間を広げる工程と、

前記引き伸ばされた素子間の間隙を含む前記ウエハ表面に前記突起電極を露出させた状態で封止樹脂を形成する工程と、

前記封止樹脂から露出した突起電極上にボール電極を形成する工程と、

前記素子間の間隙に形成された封止樹脂の前記素子側面の樹脂を残した状態で前記素子を個片に分割する工程と、

を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は樹脂封止された半導体素子、特にLSIチップと略同じサイズのチップサイズパッケージに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来このような分野の技術としては、半導体素子上にリードを形成し、このリードの一部にバン

封止するものがあった。このような技術は特開平8-306853号公報に開示されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した半導体素子の製造方法では、個々のチップに分割してから個々のパッケージを作成しているため、その作成に工程数がおおくなり、製造が煩雑になる。

【0004】本発明は、チップサイズパッケージを容易に作成できる製造方法を提供すると共に、その製造方法に適した形状の半導体装置を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明では、半導体装置において、表面に突起電極を有する半導体素子と、この半導体素子表面および側面を覆う封止樹脂と、封止樹脂から露出する突起電極と接続するボール電極とを備えたものである。

【0006】また、半導体装置の製造方法において、表面に複数の素子領域を備えたウエハの複数の素子領域に突起電極を形成する工程と、ウエハ表面に前記複数の素子領域の境界を示す凹部を備えた封止樹脂を突起電極の表面を露出させて形成する工程と、封止樹脂から露出した突起電極上にボール電極を形成する工程と、凹部を基準として前記複数の素子領域を個々の素子に分割する工程とを備えたものである。

【0007】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。図1は本発明の第1実施形態を説明する断面図であり、1はLSIチップ、2は1辺が約50～100μm、高さ約15μmの金めっき等で形成されたパンプ電極、3はLSIチップ表面保護のためのエポキシ樹脂であり、LSIチップ1の表面と側面を覆っている。また、エポキシ樹脂3の表面はパンプ電極2の表面と同じ高さになっている。4は外部基板と接続するためのハンダボールであり、直径約300～500μm程度の球状である。

【0008】次にこのような半導体素子の製造方法の第1の実施形態を図2(a)～(h)を参照しながら説明する。

【0009】まず、図2(a)に示すように、回路素子の形成されたウエハ5上の図示しないアルミ電極上にパンプ電極2を金めっき等で形成する。パンプ電極2の大きさは1辺が約50～100μm、高さ約15μmとする。

【0010】次に、図2(b)に示すように、ウエハ5の裏面をスクライプシート7を用いてスクライプリング8に張り付け、ダイヤモンドブレード9等で図2(c)に示すように個片に分割する。ここで、ダイヤモンドブレード9の幅は、およそ60μm程度のものを用いる。

【0011】次に、図2(d)に示すように、スクライ

プシート7に支持されている個片に分割済のウエハ5をスクライプリング8、スクライプシート7と共にモールド金型10に入れる。上下の金型で挟んだ際に上金型を1パンプ当たり50gf程度の圧力で押さえ、金型温度は約180℃でプレスすることにより、金パンプ2の表面高さを揃える。その後、ゲート11より樹脂12を注入する。図2(e)は図2(d)において樹脂を注入後、金型10をはずした状態を示している。この図に示されるように、パンプ電極2の上面が露出した状態で樹脂12が形成されている。

【0012】その後、図2(f)に示すように、パンプ電極2の上面にハンダボール4を搭載する。ハンダボール4の搭載方法としては、パンプ電極2上にフラックスを塗布し、その上にハンダボール4を載せ、その後200～250℃の熱を加え、ハンダボール4とパンプ電極を接合させることにより搭載することができる。ハンダボール4を搭載後、図2(g)に示されるように、分割された隙間に樹脂が注入されているウエハをダイヤモンドブレード14等で個々のチップに再度分割すること、図2(h)に示すように、LSIチップ1の側面も樹脂で覆われたチップサイズパッケージを得ることができる。ここで、ダイヤモンドブレード14の幅はおよそ40μm程度であり、ダイヤモンドブレード9の幅よりも細かいものを用いているため、容易にLSIチップ1の側面に樹脂を残した状態で個々のチップに分割することができる。

【0013】また、図2(b)において、ダイヤモンドブレード9の幅を、図2(g)に示すダイヤモンドブレード14の幅の2倍程度とすれば、図2(h)におけるLSIチップ1側面の樹脂の厚さを十分確保することができ、側面の樹脂のはがれに対してより高い強度を得ることができる。

【0014】次に本願発明の製造方法の第2の実施形態について図3(a)～(h)を用いて説明する。図2と対応する箇所には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【0015】第2の実施形態では、まず、回路素子の形成されたウエハ5上の図示しないアルミ電極上にパンプ電極2を金めっき等で形成する。

【0016】次に、図3(b)に示すようにダイヤモンドブレード14を用いてウエハを個片に分割する。ここで用いるダイヤモンドブレード14は、第1の実施形態の図2(g)に示す幅の細かいものを用いる。

【0017】次に、図3(c)に示すようにスクライプシート7を引き伸ばし、個片に分割されたウエハ間を広げる。ここで、個片に分割されたウエハ間の間隔は約100μm程度とする。

【0018】次に、第1の実施例と同様に金型10を用いてLSIチップ個片間の隙間も含めたLSIチップ表面全体を樹脂にて封止する。

【0019】次に、図3(f)に示すようにパンプ電極2上にハンダボール4を搭載する。

【0020】ハンダボール4搭載後、図3(g)に示すように、ダイヤモンドブレード14を用いて樹脂の充填されたLSIチップ間を再度分割する。それにより、図3(h)に示すようにLSIチップ1側面も樹脂で覆われたチップサイズパッケージを得ることができる。

【0021】この第2の実施形態で示される製造方法によれば、ウエハを最初に分割する際のダイヤモンドブレードの幅を薄くできるのでダイヤモンドブレードで削る部分が少なくなり、ウエハ面内のチップ取り数が増加する。また、2回の分割工程において同一のダイヤモンドブレードを用いることができるため、製造装置を簡略化することができる。

【0022】また、上述の製造方法において、図4に示すように、半導体ウエハ5の図示しない電極パッド上にワイヤボンディング方式でスタッドパンプ電極2'を形成してもよい。この場合、ウエハの品種に応じてホトリソマスクを作成する必要がなく、部材コストを削減できる。また、一般に、ホトリソ・メッキ方式でパンプを形成する場合には多額な設備投資が必要となるが、スタッドパンプ方式の場合はワイヤボンダーがあればことが足りてしまうので、従来工程で用いている設備を用いることができ、設備コストも低減できる。

【0023】また、図5に示すように、半導体ウエハ5上のパンプ電極2あるいはスタッドパンプ電極2'の表面の高さをツール16を用いて揃えてもよい。この場合、半導体ウエハ5をステージ15の上の上に載せ、ツール10を温度100℃、荷重約50gfパンプ、程度の条件として、パンプ電極を押さえる。このように、ツール16を用いてパンプ電極の表面高さを揃える場合、処理するウエハの厚さにばらつきがあったとしても、パンプ電極を適切な高さに揃えることができる。

【0024】また、個片に分割されたLSIチップの裏面にも樹脂を形成してもよい。樹脂は、たとえば、LSIチップを再度分割後、裏面に樹脂を塗布する。あるいは回路素子の形成されたウエハ5上にパンプ電極2を形成した後、ウエハ裏面にスピンコート法で樹脂を塗布することにより形成する。この場合、チップ裏面の欠けも防ぐことができ、さらに信頼性の高いチップサイズパッケージを提供することが可能となる。

【0025】次に、図6(a)～(f)を用いて本発明の製造方法の第3の実施形態を説明する。図2および図3と対応する箇所には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【0026】図6(a)に示すように、回路素子の形成されたウエハ5上の図示しないアルミ電極上にパンプ電極2を金めっき等で形成する。パンプ電極2の大きさは1辺が約50～100μm、高さ約15μmとする。

【0027】次に、図6(b)に示すように、このパンプ

ブ電極が形成されたウエハ7を金型に入れる。上下の金型で挟んだ際に上金型を1パンプ当たり50gf程度の圧力で押さえ、金型温度は約180℃でプレスすることにより、金パンプ2の表面高さを揃える。ここで、上金型17の表面にはウエハを個片チップに分割する際の対応する位置に突起部18が設けられている。その後ゲート11より、樹脂を注入する。

【0028】このようにして注入された樹脂は、図6(c)に示すように、封止樹脂12の上金型17の突起部18に対応する位置に凹部19が形成されている。

【0029】次に、図6(d)に示すように、パンプ電極2の上面にハンダボール4を搭載する。

【0030】次に、図6(e)に示すように、樹脂12表面に形成されている凹部19を目印としてダイヤモンドブレード14によりウエハ5を個々のチップに分割し、図6(f)に示すようなチップサイズパッケージが得られる。

【0031】この第3の実施形態によれば、一般的には不透明である樹脂12の分割する位置に凹部を設けているため、個々のチップに切断する際に目印となり、作業効率が向上する。さらに、凹部に沿って切断するため、切断する樹脂部の厚さが薄くなり、ダイヤモンドブレード14の消耗量も低減できる。

【0032】また、上述の図6(b)の工程で、パンプ電極2の表面から所定間隔の逃げ部を有し、ウエハ5表面近傍まで達する凸部を有する金型を用いて樹脂を注入してもよい。その場合、ウエハ5上に形成された封止樹脂からはパンプ電極が露出していないので、研磨等により露出させる。このようにすると、金型のクリアランスを余裕を持って設計することが可能となり、金型製造コストを低減することができるとともに、処理する個々のウエハの厚さおよびパンプ電極の高さに多少のばらつきがあってもそれを吸収することができる。

【0033】また、上述の各実施例においては、パンプ電極の材質として金を用いているが、ハンダを用いてもよい。ハンダを用いた場合は、その後形成するハンダボールとの相性が良くなり、密着強度が向上する。また、ハンダは安価であるので材料コストを低減できる。

【0034】

【発明の効果】本発明に係る半導体装置およびその製造方法によれば、LSIチップの側面あるいは裏面に樹脂が形成されているので、チップの欠けを防止することができ、信頼性の高いチップサイズパッケージを容易に製造することができる。

【0035】また、ウエハ表面に形成された樹脂に、LSIチップを個片に分割する際の切断部分を示す凹部を設けたので、個片に分割する際に目印となり、正確に分割することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態を示すチップの断面図

である。

【図2】本発明の製造方法の第1の実施形態の製造工程図である。

【図3】本発明の製造方法の第2の実施形態の製造工程図である。

【図4】本発明の製造方法の第2の実施形態の変形例を示す図である。

【図5】本発明の製造方法の第2の実施形態の他の変形例を示す図である。

【図6】本発明の製造方法の第3の実施形態を示す図である。

【符号の説明】

1 LSIチップ

2 パンプ電極

2' スタッドパンプ電極

* 3 エポキシ樹脂

4 ハンダボール

5 ウエハ

7 スクライプシート

8 スクライプリング

9 ダイヤモンドブレード

10 金型

11 ゲート

12 樹脂

14 ダイヤモンドブレード

15 ステージ

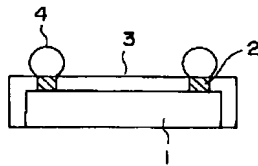
16 ツール

17 上金型

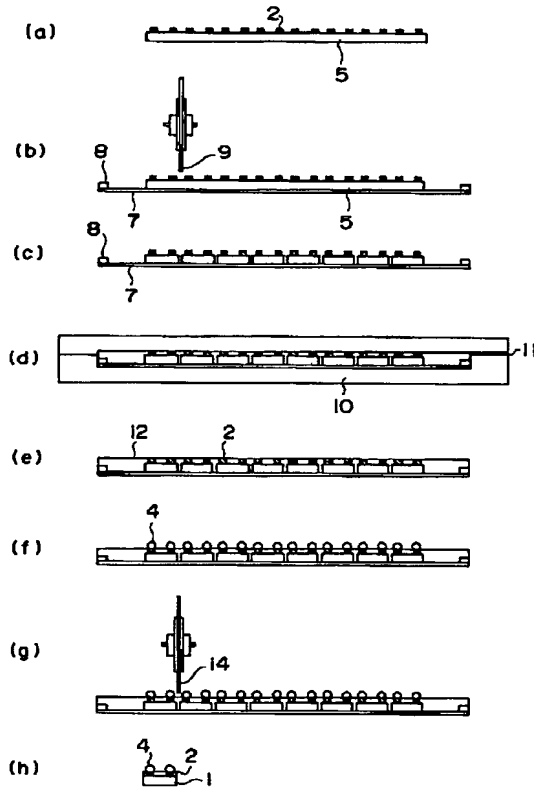
18 突起部

* 19 凹部

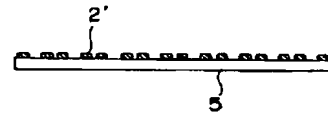
【図1】



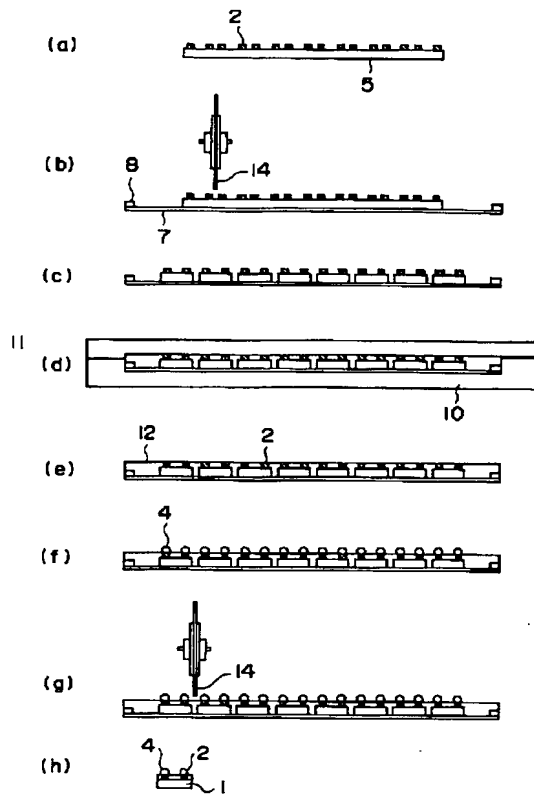
【図2】



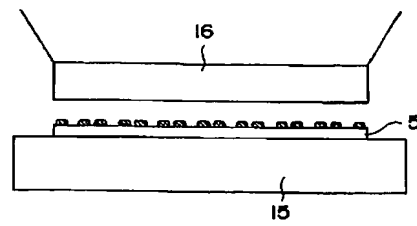
【図4】



【図3】



【図5】



【図6】

